

ニュースガイド No. 10700

<日本特許・実用新案明細書収録セット>
 *最新の特許情報が満載!

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成23年(1年間) 59点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥18,900-	¥18,000-
全文紙収録 B5製本版	¥18,900-	¥18,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥28,350-	¥27,000-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	点	(本体価格)
No,10579	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.22 59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21 60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20 60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19 66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18 66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17 84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16 65点	¥19,200
No,9997A	"	"	平.15 62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-平.14 84点	¥16,800
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-平.9 65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19 62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17 100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12 68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12 71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12 70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12 71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11 81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-平.11 75点	¥29,700
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12 68点	¥24,700

*お申し込み方法...下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
所属部署名	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

無電解貴金属メッキ方法と工程

No. 10700

[公開編] 平成23年(1年間) 59点

CD-ROM版 ¥18,900 B5製本版 ¥18,900 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥28,350)

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 高分子基材のめっき前処理方法 | 日立マクセル株式会社 | 29 シリコンゴム表面への金属固定方法 | 藤倉ゴム工業株式会社 |
| 2 めっき膜を有するポリマー部材の製造方法 | 日立マクセル株式会社 | 30 ダイヤモンド微粒子を分散させた複合めっき液及びその製造方法 | アイテック株式会社 |
| 3 貴金属で表面修飾されたナノポ - ラス金属及びナノポ - ラス金属の貴金属による表面修飾 | 国立大学法人東北大学 | 31 金属ナノワイヤー及びその製造方法、並びに透明導電体及びタッチパネル | 富士フイルム株式会社 |
| 4 半導体装置の製造方法及び半導体装置の製造装置 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 32 金属多層積層電気絶縁体とその製造方法 | ダイソー株式会社 |
| 5 パターンが施された金属箔の製造方法、導体層パターン付基材の製造方法、めっき用導電性基材及び... | 日立化成工業株式会社 | 33 導電性粉体及びそれを含む導電性材料並びに導電性粒子の製造方法 | 日本化学工業株式会社 |
| 6 半導体装置およびその製造方法 | 株式会社デンソー | 34 異方性導電フィルム、接合体及び接続方法 | ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社 |
| 7 プリント配線板用触媒残渣除去剤 | 奥野製薬工業株式会社 | 35 半導体装置の製造方法 | 三菱電機株式会社 |
| 8 積層体、その製造方法、積層体を備える薄膜トランジスタ、および積層体を備えるプリント配線基板 | ブラザー工業株式会社 | 36 金属被覆粒子の製造方法 | 株式会社日本触媒 |
| 9 メッキ粉体 | 三井化学株式会社 | 37 無電解金めっき液及びそれを用いて得られた金皮膜 | 日本高純度化学株式会社 |
| 10 機能性粒子およびプラズマ処理を用いたその製造方法 | 三井化学株式会社 | 38 気泡発生用部材およびこれを用いた気泡発生装置並びに気泡発生方法 | 京セラ株式会社 |
| 11 金属担持物製造装置及び金属担持物製造方法 | 国立大学法人北海道大学 | 39 導電粒子 | 日立化成工業株式会社 |
| 12 複合金属ナノ粒子とその製造方法および複合金属ナノ粒子を含む多光子吸収材料または多光子吸収反応助剤 | 株式会社リコー | 40 貴金属物品の製造方法 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 13 無電解ニッケル - パラジウム - 金めっき方法、めっき処理物、プリント配線板、インターポーザ、および半... | 住友ベークライト株式会社 | 41 めっき方法 | 株式会社村田製作所 |
| 14 無電解めっき素材の製造方法 | 株式会社豊田自動織機 | 42 導電性繊維およびその製造方法 | 帝人ファイバー株式会社 |
| 15 無電解めっき素材の製造方法 | 株式会社豊田自動織機 | 43 半導体装置用リードフレームとその製造方法 | パナソニック株式会社 |
| 16 導電性微粒子の製造方法及び導電性微粒子 | 積水化学工業株式会社 | 44 塗工物の製造方法及び塗工物 | 日本ペイント株式会社 |
| 17 導電性パターン形成方法 | 三菱製紙株式会社 | 45 繊維めっき治具、及び、これを用いた繊維めっき方法 | 名古屋メッキ工業株式会社 |
| 18 導電性組成物を用いた構造体の作製方法および構造体 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 46 金属 - セラミックス回路基板およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 |
| 19 めっき膜、プリント配線板及びモジュール基板 | TDK株式会社 | 47 金属ナノ構造体およびその製造方法 | 奥野製薬工業株式会社 |
| 20 導電性微粒子及び異方性導電材料 | 積水化学工業株式会社 | 48 めっき液の活性度測定装置及びその方法 | サムソン エレクトロ - メカニックス カンパニーリミテッド. |
| 21 微細スルーホールを有するプリント配線基板およびその製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 | 49 無電解パラジウムめっき又は無電解パラジウム合金めっきの前処理用活性化液 | 奥野製薬工業株式会社 |
| 22 金属インキ並びにそれを用いた金属含有膜及びその製造方法 | 石原産業株式会社 | 50 無電解めっき法で用いる触媒溶液、その触媒溶液の調製方法及びその触媒溶液を用いた無電解めっき法並び... | 株式会社関東学院大学表面工学研究所 |
| 23 成形回路部品 | 三共化成株式会社 | 51 生理活性化作用のある光を発生する発光装置 | 丸山 裕之 |
| 24 被覆層付部材の表面処理方法及びその表面処理方法を施した部材 | メルテックス株式会社 | 52 アルミニウム構造体の製造方法およびアルミニウム構造体 | 住友電気工業株式会社 |
| 25 置換型無電解金めっき液、及びこれを用いた金めっき層の形成方法 | サムソン エレクトロ - メカニックス カンパニーリミテッド. | 53 配線方法、並びに、表面に配線が設けられた構造物、半導体装置、配線基板、メモリカード、電気デバイス... | パナソニック電工株式会社 |
| 26 複合体微粒子、その製造方法、並びにそれを用いた導電膜形成用組成物、及び導電膜の形成方法 | 東ソー株式会社 | 54 電子回路付き基板及びその製造方法、並びに混合型電子回路形成キット | 有限会社 緒方材料科学研究所 |
| 27 複合体の製造方法 | 財団法人地球環境産業技術研究機構 | 55 耐変色性コーティング | エントン インコーポレイテッド |
| 28 金属コーティング方法 | 独立行政法人理化学研究所 | | |

以下4点省略